



株式会社リョーサン

2018年度第2四半期 決算説明会

2018年11月14日

2018年度第2四半期 業績結果

2018年度通期 業績計画

第10次中期経営計画の取り組み状況

資料取扱い上のご注意

このプレゼンテーションで述べられている業績計画等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。その要因のうち、主なものは以下のとおりです。

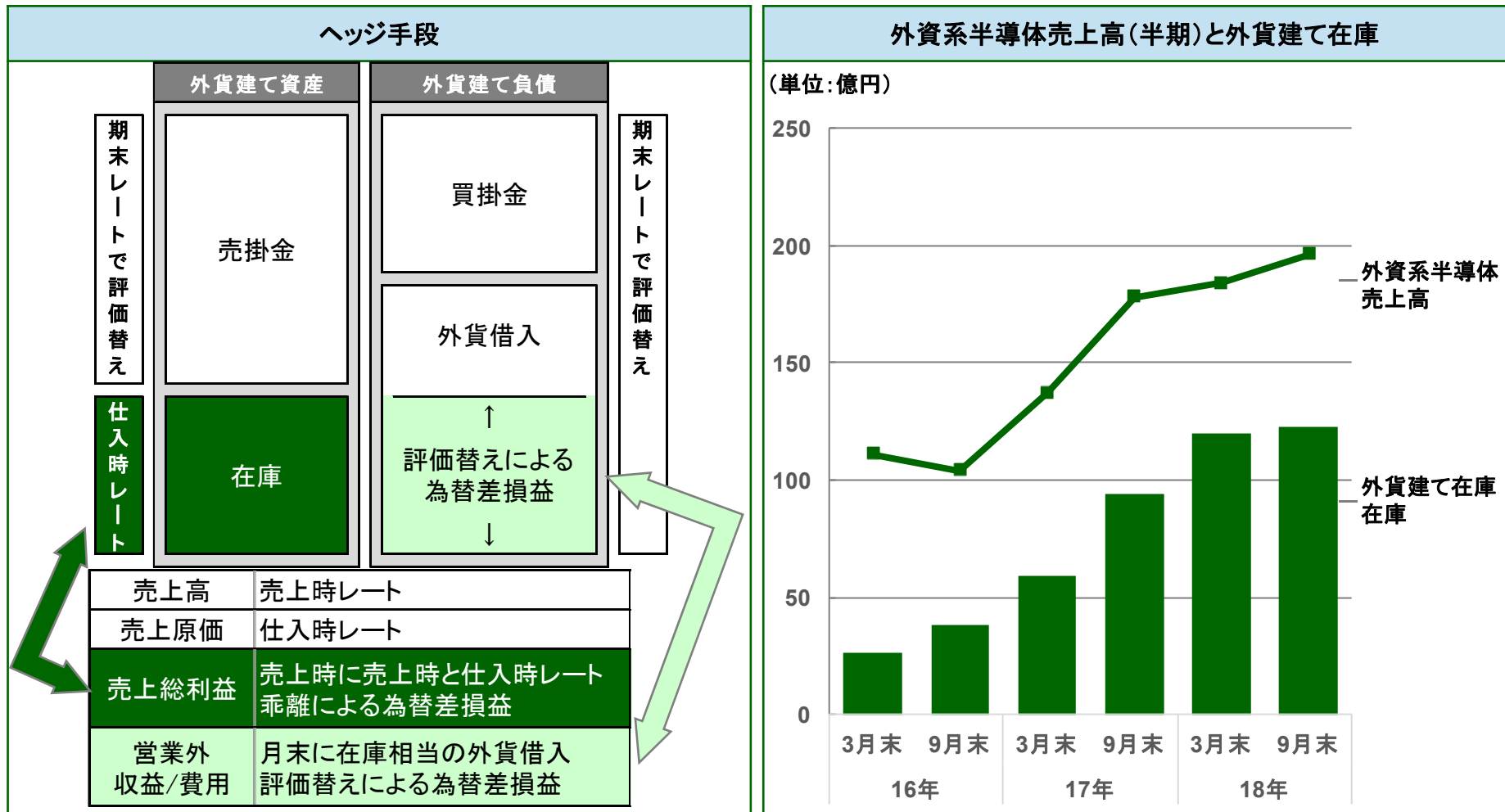
- ・主要市場（日本、アジア等）の経済状況、消費動向及び製品需給の急激な変動
- ・ドル等の対円為替相場の大幅な変動
- ・資本市場における相場の大幅な変動等

- 売上高、営業利益は期初計画を上回って着地。コンシューマ向けビジネス好調推移。
- 18年度上期末にかけて円安が進行した結果、為替差損917百万円発生。経常利益、当期純利益を押し下げ。

(単位:億円)	17年度上期	18年度上期			
	金額	金額	前年同期比	期初計画	期初計画比
売上高	1,236	1,289	+4.3%	1,275	+1.2%
売上総利益	104	107	+2.1%	105	+2.0%
売上高比	8.5%	8.3%	△0.2%	8.2%	+0.1%
営業利益	32	28	△10.2%	27	+7.2%
売上高比	2.6%	2.2%	△0.4%	2.1%	+0.1%
経常利益	31	16	△49.2%	25	△35.2%
売上高比	2.6%	1.3%	△1.3%	2.0%	△0.7%
当期純利益	22	10	△52.5%	18	△41.3%
売上高比	1.8%	0.8%	△1.0%	1.4%	△0.6%
1株当たり当期純利益(円)	82.66	43.62	△47.2%	73.51	△40.7%
米ドル 平均レート(円)	111.06	110.26	△0.7%	105.00	+5.0%

為替リスクへの対応状況

- 当社は保有する外貨建て資産と負債を外貨借入を用いてバランスさせることを原則。売上総利益部分の為替差損益を外貨借入によって生じる為替差損益でヘッジ。
- 外資系半導体事業伸張の結果、外貨建て在庫が増加。期末の為替変動影響が増大。



事業別業績の概要

2018年度第2四半期
業績結果

- 半導体事業は買収したEDAL ELECTRONICS Co., Ltd. (“EDAL”) (18年度上期売上高約50億円)の連結化等で増収。
- 電子部品事業はコンシューマ向け等のビジネスが好調継続。営業利益率も高水準。
- 電子機器事業は大口ビジネス終息の影響を受け、減収減益。

(単位:億円)		17年度上期	18年度上期			
		実績	実績	前年同期比	期初計画	期初計画比
半導体事業	売上高	720	770	+6.9%	764	+0.8%
	営業利益	18.2	13.9	△23.6%	15.0	△6.9%
	売上高比	2.5%	1.8%	△0.7%	2.0%	△0.2%
電子部品事業	売上高	395	404	+2.3%	390	+3.7%
	営業利益	13.2	14.8	+12.5%	13.0	+14.4%
	売上高比	3.3%	3.7%	+0.4%	3.3%	+0.4%
電子機器事業	売上高	120	115	△4.1%	121	△4.6%
	営業利益	2.7	1.7	△37.3%	1.5	+14.0%
	売上高比	2.3%	1.5%	△0.8%	1.2%	+0.3%
計	売上高	1,236	1,289	+4.3%	1,275	+1.2%
	営業利益	32.2	28.9	△10.2%	27.0	+7.2%
	売上高比	2.6%	2.2%	△0.4%	2.1%	+0.1%
米ドル 平均レート(円)		111.06	110.26	△0.7%	105.00	+5.0%

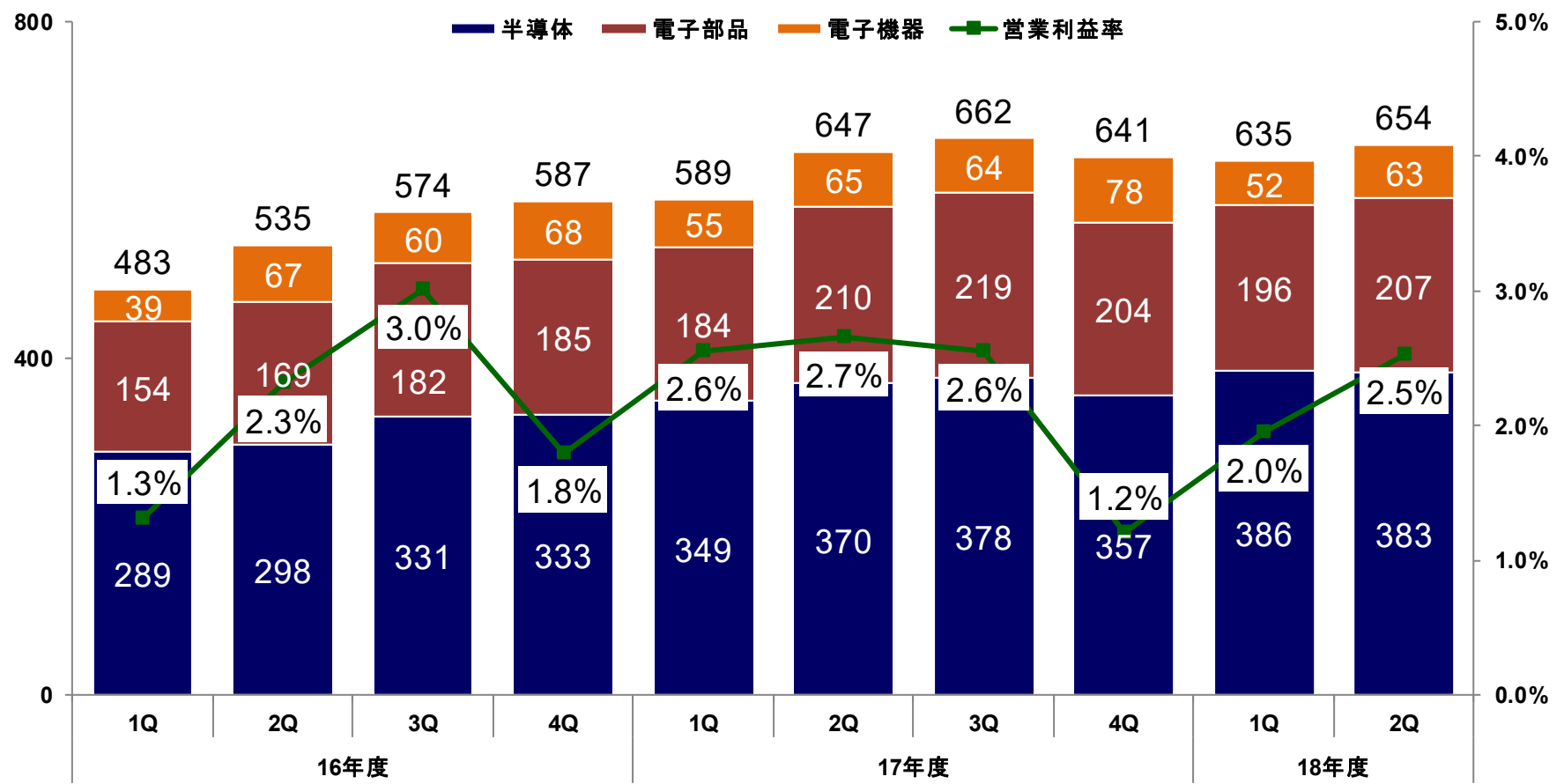
四半期毎 売上高・営業利益率

2018年度第2四半期
業績結果

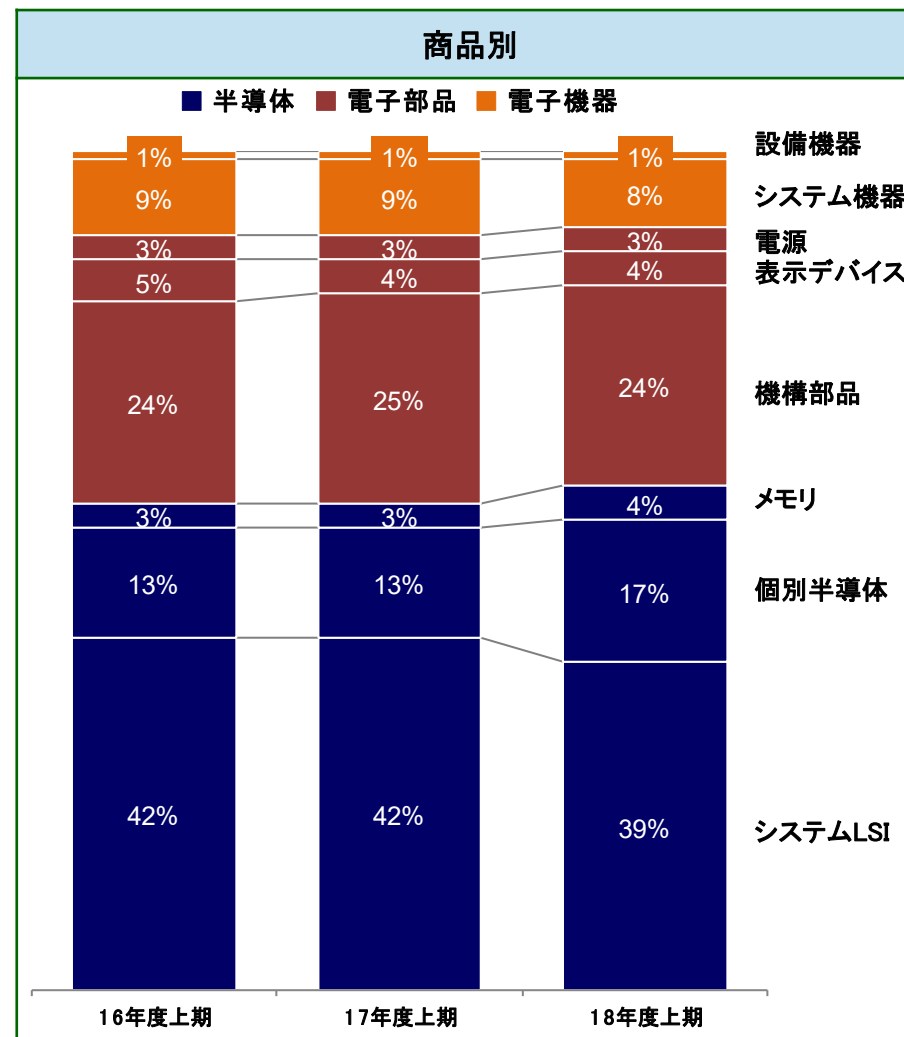
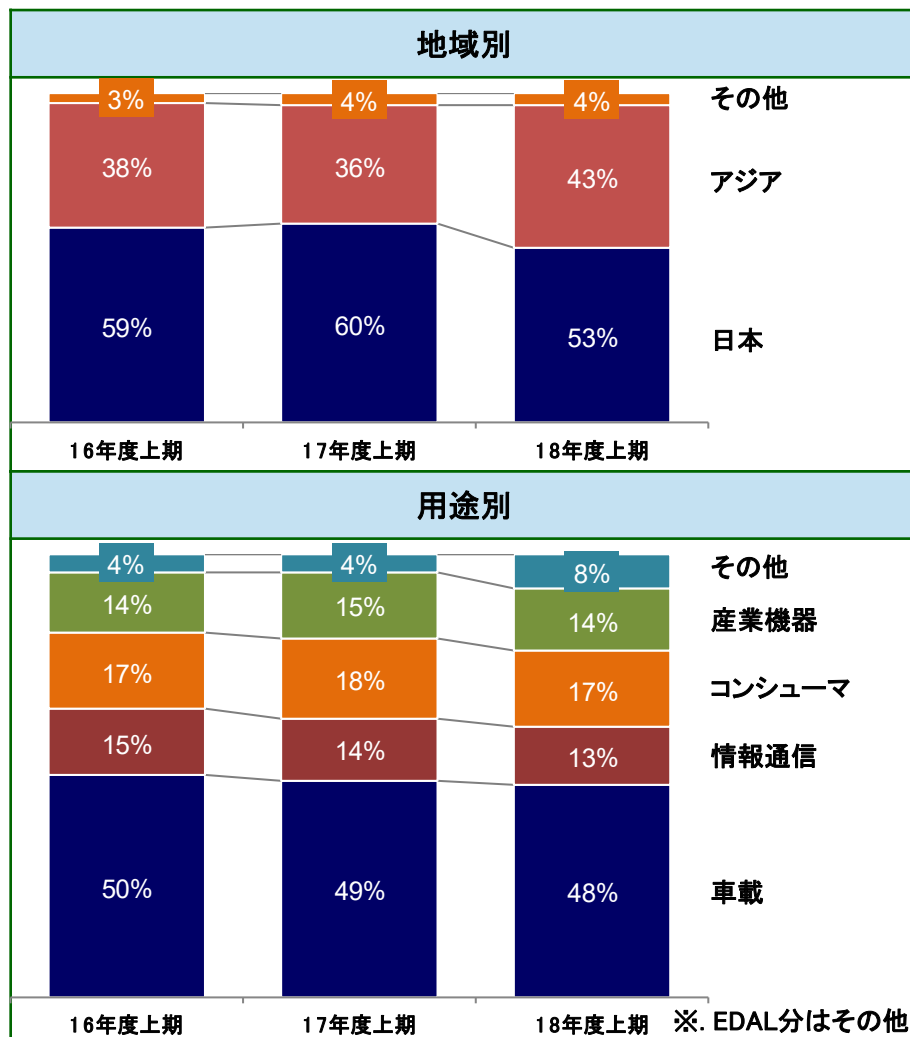
- 売上高は16年度1Qから6四半期連続増収後、600億円台の堅調推移。
- 営業利益率は17年度4Q、18年度1Qから改善。在庫関連費用減少が主因。

売上高 (単位: 億円)

営業利益率



■ EDAL連結化を受け、地域別ではアジア、商品別では個別半導体の売上高比率が上昇。



- 自己株式取得38億円、配当金支払18億円の結果、純資産は903億円。自己資本比率は56.0%に低下。
- 資産効率の改善施策として、一部売上債権を流動化。営業活動によるキャッシュ・フローはプラス90億円。現金及び現預金同等物残高は前年同期比17億円増加。

(単位:億円)	18年3月末	18年9月末	比較増減
総資産	1,622	1,613	△9
流動資産	1,435	1,430	△5
固定資産	187	183	△4
負債	679	709	+30
純資産	943	903	△40
自己資本比率	58.1%	56.0%	△2.1%

(単位:億円)	17年度上期	18年度上期	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△158	90	+248
投資活動によるキャッシュ・フロー	6	△2	△8
財務活動によるキャッシュ・フロー	△80	△51	+29
現金及び現金同等物の四半期末残高	154	171	+17

2018年度第2四半期 業績結果

2018年度通期 業績計画

第10次中期経営計画の取り組み状況

- 18年度上期業績結果に加え、産業機器分野の需要一服などの市況減速が見込まれ、期初計画を下方修正。
- 為替計画レートは105円。18年度下期見込は為替の影響を織り込まず。

(単位:億円)	17年度	18年度					
	通期	上期	下期見込	通期見込	前年同期比	期初計画	期初計画比
売上高	2,540	1,289	1,250	2,540	0.0%	2,580	△1.6%
売上総利益	203	107	103	211	+3.7%	215	△1.9%
売上高比	8.0%	8.3%	8.3%	8.3%	+0.3%	8.3%	0.0%
営業利益	56	28	27	56	△1.2%	60	△6.7%
売上高比	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	0.0%	2.3%	△0.1%
経常利益	63	16	23	40	△37.5%	56	△28.6%
売上高比	2.5%	1.3%	1.9%	1.6%	△0.9%	2.2%	△0.6%
当期純利益	44	10	17	28	△37.5%	40	△30.0%
売上高比	1.8%	0.8%	1.4%	1.1%	△0.7%	1.6%	△0.5%
1株当たり当期純利益(円)	173.98	43.62	73.59	117.21	△32.6%	163.36	△28.3%
米ドル 平均レート(円)	110.85	110.26	105.00	107.63	△2.9%	105.00	+2.5%

事業別計画の概要

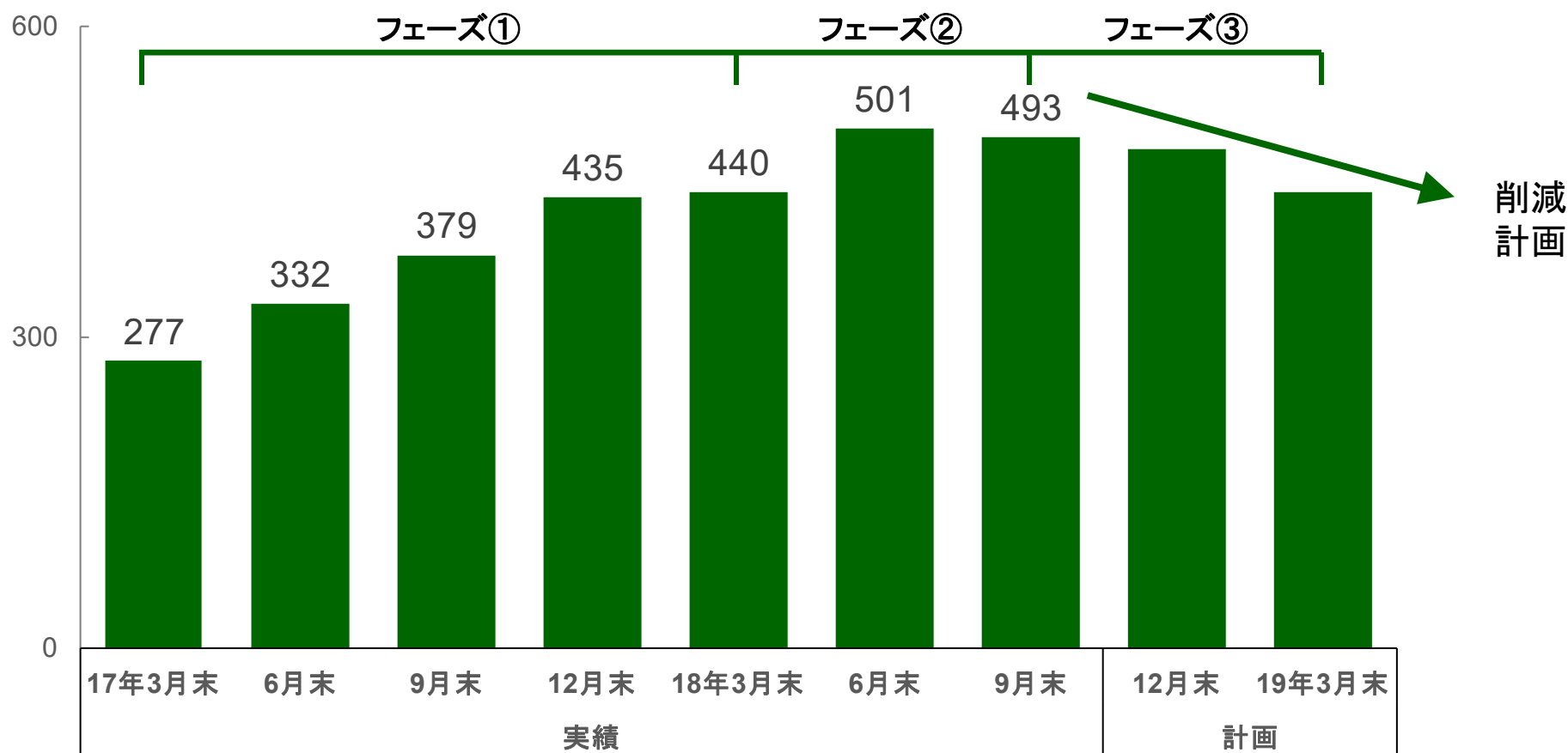
2018年度通期
業績計画

- 半導体事業は産業機器向け市況減速等の影響あるが、同事業の過半を占める車載向けは堅調推移が見込まれ、前年同期比で増収増益の計画。
- 電子部品事業は成長を牽引してきたコンシューマ向けで陰り。電子機器事業では上期までに生じた大口ビジネス終息影響等あり、前年同期比で減収減益の計画。

(単位:億円)		17年度	18年度					
		通期	上期	下期見込	通期見込	前年同期比	期初計画	期初計画比
半導体事業	売上高	1,457	770	749	1,520	+4.3%	1,545	△1.6%
	営業利益	26.2	13.9	13.5	27.5	+4.7%	34.5	△20.3%
	売上高比	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	0.0%	2.2%	△0.4%
電子部品事業	売上高	819	404	380	785	△4.2%	795	△1.3%
	営業利益	28.1	14.8	13.1	28.0	△0.4%	27.0	+3.7%
	売上高比	3.4%	3.7%	3.4%	3.6%	+0.2%	3.4%	+0.2%
電子機器事業	売上高	263	115	119	235	△10.9%	240	△2.1%
	営業利益	6.0	1.7	2.2	4.0	△34.1%	3.5	+14.3%
	売上高比	2.3%	1.5%	1.9%	1.7%	△0.6%	1.5%	+0.2%
計	売上高	2,540	1,289	1,250	2,540	0.0%	2,580	△1.6%
	営業利益	56.6	28.9	27.0	56.0	△1.2%	60.0	△6.7%
	売上高比	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	0.0%	2.3%	△0.1%
米ドル 平均レート(円)		110.85	110.26	105.00	107.63	△2.9%	105.00	+2.5%

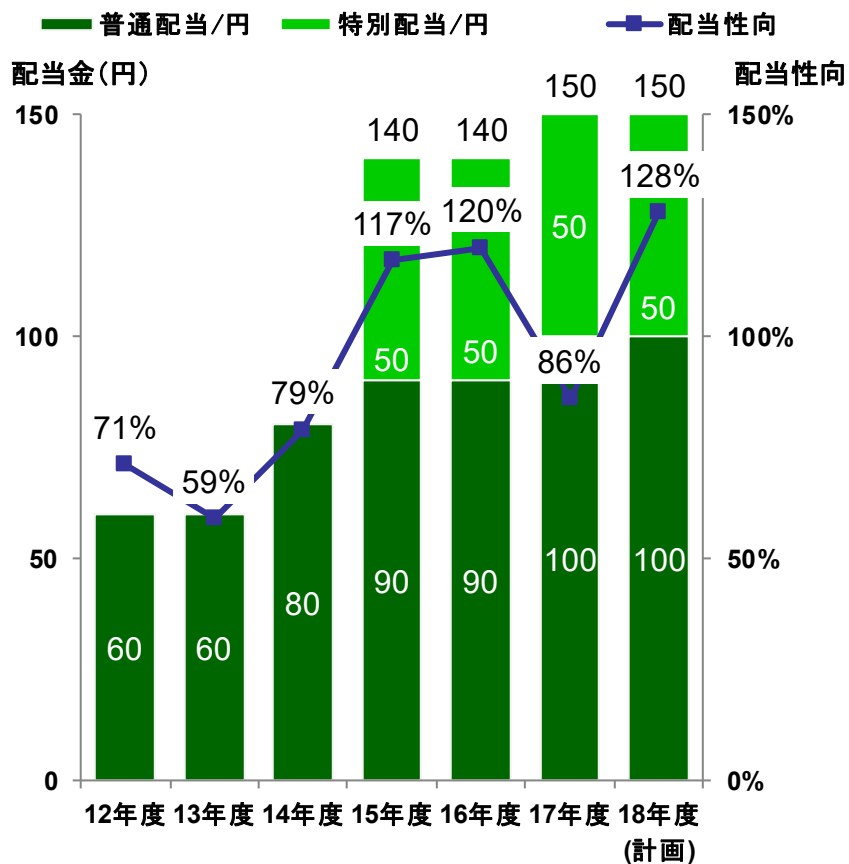
- 車載向けBCP対応、外資系半導体事業拡大(フェーズ①)。
- EDAL連結化、産業機器向け等の在庫積み上がりにより500億円水準(フェーズ②)。
- 18年下期は発注調整等を通じ、1割強削減する計画(フェーズ③)。

連結在庫金額(単位:億円)



- 18年度配当は普通配当金100円、特別配当金50円、計150円を計画。
- 自己株式取得は本年度も継続実施中。

1株当たり配当金



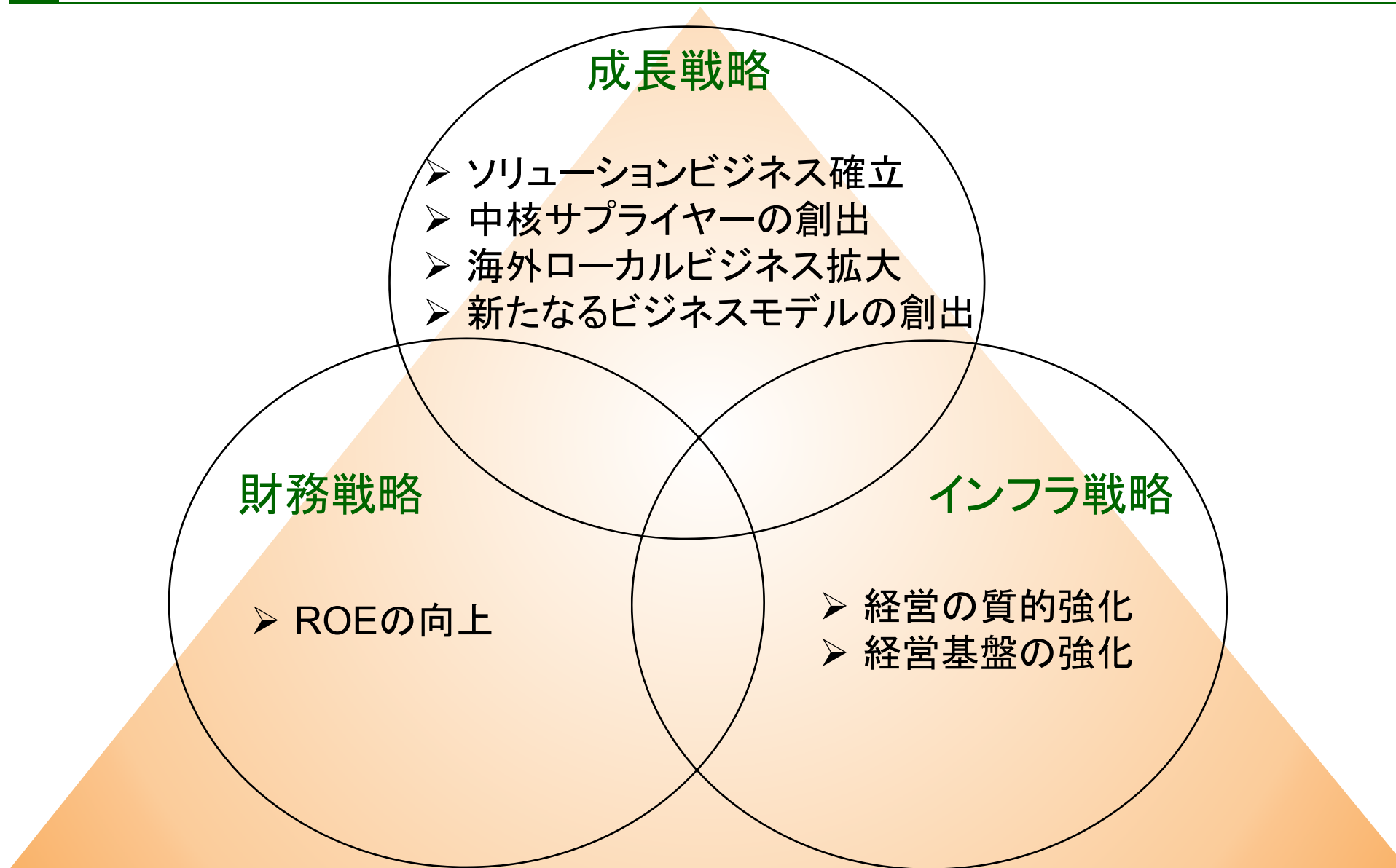
自己株式の取得

年度	取得株数 (万株)	金額 (億円)
12年度	100	19
13年度	100	19
14年度	45	18
15年度	155	46
16年度	137	44
17年度	361	159
18年度 (11月5日現在)	105	42

2018年度第2四半期 業績結果

2018年度通期 業績計画

第10次中期経営計画の取り組み状況



ソリューションビジネスの確立

- ・ アイオーコアへの追加投資通じた関係強化。
- ・ 車載加飾、インバウンド、バイタルセンシング各新サービス開始。
- ・ 第21回組込みシステム開発技術展(ESEC)出展。

事業の中核を担う更なるサプライヤーの創出

- ・ ボリューム拡大が一服。収益性向上を目指したオペレーションの効率化に軸足シフト。
- ・ 更なる事業規模拡大を企図し、ノン・オーガニックの取組みを推進中。

海外ローカルビジネスの拡大

- ・ EDAL、青島三源泰科(※)とのシナジー創出に向けた取組みを推進。電子部品で具体化成果。更なるシナジーの拡大が課題。
※. 18年1月出資したモーターコントローラーの開発・製造・販売会社

新たなビジネスモデルの創出

- ・ 社長直轄のプロジェクトを推進。

下期の取組み

- ・ 各種新規ビジネスモデル「事業化」促進
- ・ アイオーコア事業の商業化に向けた各種サポート

- ・ オペレーション効率化に向けたシステム投資・人員配置の最適化
- ・ 事業投資案件の発掘

- ・ 中華圏事業の更なる拡大
- ・ 電子部品事業の海外ローカルビジネス再構築
- ・ 海外商社M&Aの更なる促進

- ・ 既存取引先同士を当社が“つなぐ”、新しいビジネスを創出

経営の質的強化

- リョーサンスピリットの実践として、価値観研修(ラウンドアップシステム)を継続実施。
- ESGへの取り組みの一環として、サプライチェーン管理の枠組み整備。リスク分析のPDCAサイクルを高度化。加えて、開示情報強化に向けた非財務情報の整備を推進。
- M&Aを通じたグループ範囲の拡大を踏まえ、内部統制の強化に向けた取り組みを加速化。

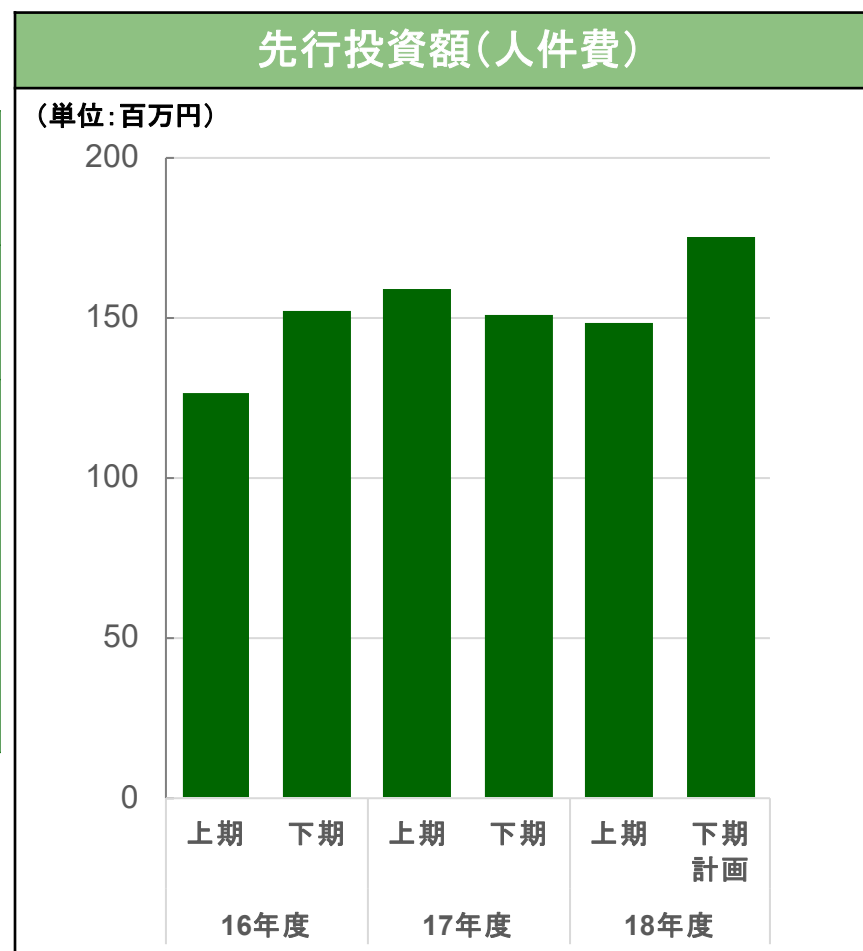
経営基盤の強化

- 間接業務機能の効率化の観点から、社内横断的な業務プロセス改革を推進。基幹システムとは切り離れた「デリバリー予実管理システム」の導入予定
- 更なる基盤強化に向け、マーケットの特性に応じた組織体制再構築・人事制度の見直し等対応中。

- システムソリューション、車載ソリューション、アナログセンサーソリューションの3つのテーマでビジネス化を推進。
- ソリューションビジネスの事業化に向けて、各施策に取り組む。

◆ 下期の取り組み

システムソリューション	<ul style="list-style-type: none"> ・ サービス課金ビジネスモデルの確立。
車載ソリューション	<ul style="list-style-type: none"> ・ 車載加飾ビジネスのTier1への展開推進。
アナログセンサーソリューション	<ul style="list-style-type: none"> ・ アイオーコアへの追加出資により関係強化。ビジネス拡充に向け、デザインイン活動促進。 ・ 協働型ロボットビジネスへの取り組み。



- 18年度よりEDALを連結化。
- 主に中国、韓国エリアにおいて、既存のルネサスビジネスの拡大に加え、電子部品を中心とした新規ビジネスの発掘を目指す。

◆ **中国エリア** 注力分野: **車載・産業** **白物家電**

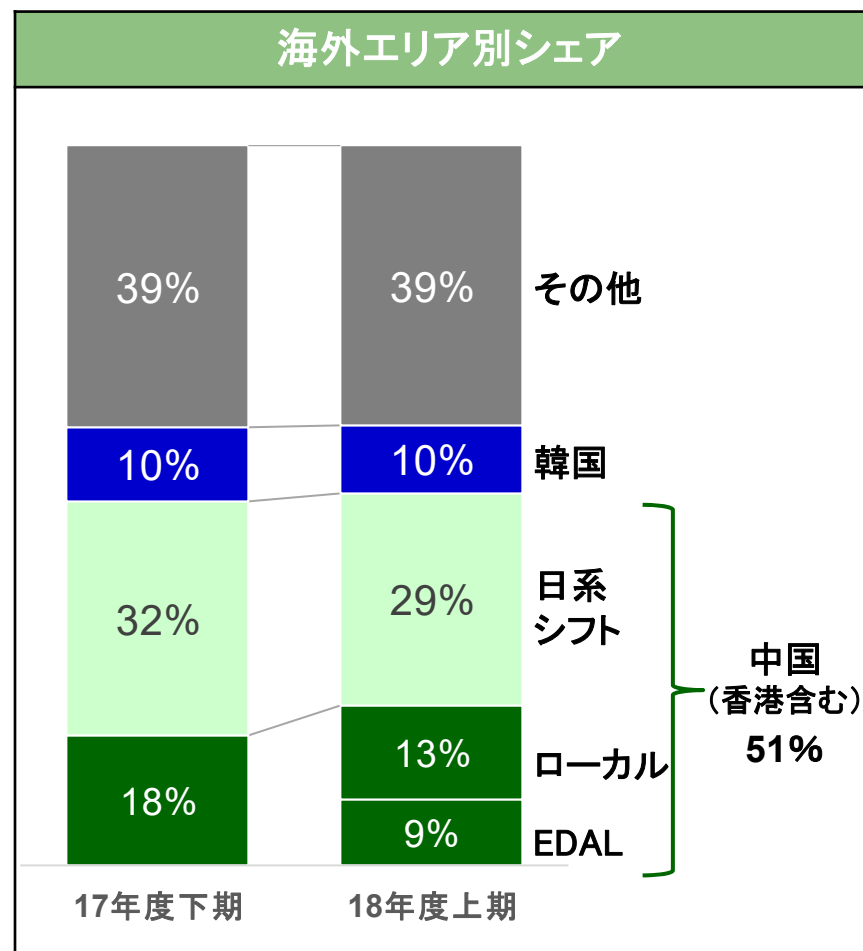
- ・ EDAL、青島三源泰科を活用。ローカル顧客に対して拡販推進。

◆ **韓国エリア** 注力分野: **車載**

- ・ ローカルの車載系顧客に対して、先端素材応用製品・高機能製品、センサーモジュールの拡販推進。

◆ **戦略的パートナーとのアライアンス**

- ・ 中国、欧州エリアにおける海外ローカル商社のM&Aを推進。シナジー創出が期待できる投資先を継続して模索。



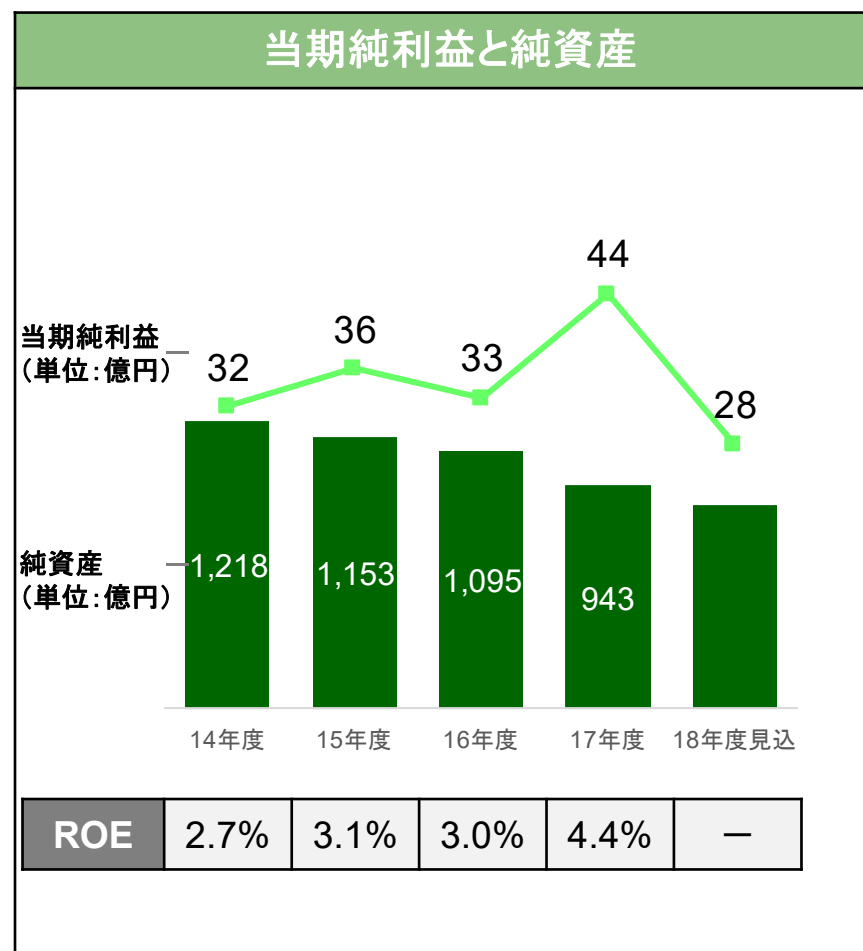
- 資本効率向上に向けて、収益性の向上、資産効率の改善、最適な株主資本実現の各施策を実行し、19年度にROE5%を目指す。

◆ 資本効率の向上に向けた施策

中計施策	具現策
収益性の向上	<ul style="list-style-type: none"> ・優良な戦略投資先候補の模索 ・経費の効率化
資産効率の改善	<ul style="list-style-type: none"> ・売掛債権の流動化 ・政策保有株式の縮減
最適な株主資本実現	<ul style="list-style-type: none"> ・自己株式取得(18年度 200万株) ・特別配当(18年度 50円)



19年度 ROE5%を目指す



ご参考

－ ソリューション事業のご紹介 －

新規ビジネスとしてサービス課金ビジネスの受注を開始。
Sierとの協業で18年9月よりサービス開始。

顧客		用途	提供サービス
自治体	市町村、観光地等	観光行動調査分析	<ul style="list-style-type: none"> ・レポート ・ダッシュボード (データ概要一覧表示)
公共インフラ	交通機関、施設等	顧客動向分析 既存ICTサービス との連携	<ul style="list-style-type: none"> ・レポート ・分析データ
リテール	商店街、百貨店 ショッピングセンター等	顧客マーケティング (導線調査・分析等)	<ul style="list-style-type: none"> ・レポート ・分析データ

新しいサービスに向け、パートナーとリアルタイムセンサーを開発中

- 特 徴 : センサー周辺のデータをリアルタイム(一定時間毎)に提供
用 途 : SierのICTリアルタイムサービス
サイネージ等へのインバウンド向けサービス付加



【センサー(開発中)】



シリコンフォトニクス技術を用いて
100Gb/sクラスの光モジュールとしては世界最小サイズを実現
(5mmサイズに、Tx/Rxそれぞれ25Gbpsx4ch機能を集積)

小型・低消費電力の光I/Oコアで新しい光通信市場の創出を目指す

光I/Oコア

量子ドットレーザ
光ピン(光IF)

ドライバ/TIA
TGV(電気IF)

大規模ルータやスイッチなどの
伝送装置間や
放送機器間との接続

装置間

性能	
伝送容量	25Gbps x 4ch
消費電力	~1W
動作温度	-40℃~85℃
光IF接合精度	±10μm

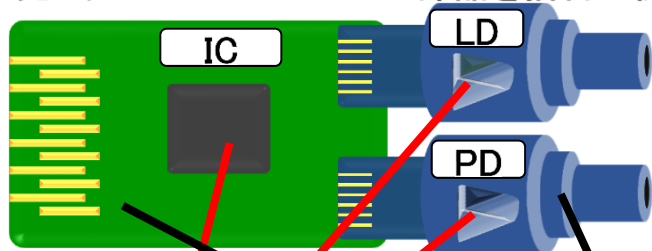
基板間 **LSI間**



小型化により、光I/Oコアは様々な用途へカスタマイズ可能

既存光トランシーバ

光トランシーバメーカーが部品を摺合せ開発



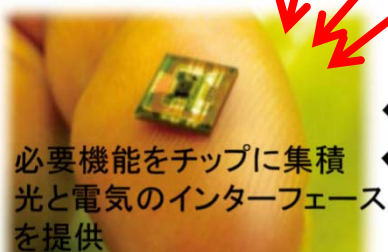
光トランシーバ標準



光コネクタ
電気コネクタ
サイズ、性能...

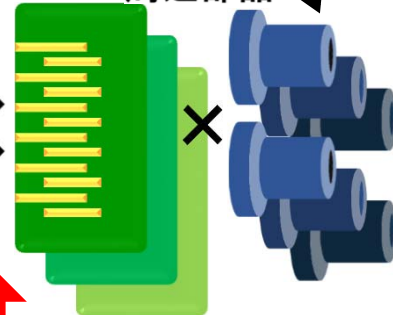
用途が限られる

光I/Oコア



必要機能をチップに集積
光と電気のインターフェース
を提供

周辺部品



組込型光モジュール



様々な用途に展開可能

・既存の光トランシーバではできないシステム
への組み込みが可能。

チップの光/電気の
ユーザーインターフェース

光/電気のインターフェースを標準化。
ユーザーや顧客は周辺部品をカスタマイズ。

高精度な位置合わせを必要としない光接続

【特徴1】

様々な触れ合うインターフェースが可能。



【特徴2】

様々な大きさ、形状、曲面が可能。



用途例: ロボット、FA機器

- ・ 複雑な形状をセンシングしたい
- ・ 安全性の向上
- ・ デザインを崩さずセンシングしたい
- ・ キーデバイス、音声認識+αのユーザーインターフェースを追加したい

